

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2017-073

惠州中京电子科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

适用 不适用

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中京电子	股票代码	002579
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余祥斌	黄若蕾	
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号	
电话	0752-2057992	0752-2057992	
电子信箱	obd@ceepcb.com	huangruolei@ceepcb.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	512,056,484.03	346,243,167.79	47.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,603,162.61	91,604,543.32	-93.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,202,511.20	931,053.54	351.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,914,779.58	-15,236,505.73	204.45%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.24	-95.83%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.24	-95.83%
加权平均净资产收益率	0.56%	13.19%	-12.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,607,420,772.21	1,566,287,988.44	2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	948,987,000.60	971,928,664.65	-2.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,247	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
惠州市京港投资发展有限公司		29.61%	111,858,462	0	质押	86,650,000
香港中扬电子科技有限公司		18.92%	71,492,613	0		
杨林		6.85%	25,871,832	25,871,832		
紫光集团有限公司		0.98%	3,684,900	0		
惠州市普惠投资有限公司		0.65%	2,448,310	0	质押	779,999
林道治		0.53%	2,000,000	0		
张敬兵		0.51%	1,942,900	0		
中央汇金资产管理有限责任公司		0.44%	1,647,200	0		
王泽		0.27%	1,031,708	0		
刘德威		0.27%	1,020,000	1,020,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定					

	的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司根据董事会既定战略发展目标，围绕“继续做大做强 PCB 主业，积极推动创新业务发展”的战略发展计划，有序开展各项工作，具体情况如下：

一、PCB 产业综合能力提升

公司继续加强对 PCB 产业的发展力度，深挖潜能，提升产销规模与盈利能力。

1、工艺技术提升：公司二阶 HDI 产品已实现大批量生产，三阶 HDI 产品小批量生产，并具备部分 Any-layer HDI 的量产能力。公司在控深盲孔、非平面台阶型特殊 HDI 产品技术已经处于行业领先水平。

同时，公司已逐步开展对金属铜基板、5G 高速 PCB 板、特殊金手指等新产品的研究开发。

2、产品结构优化：借力于技术提升、设备优化及市场营销拓展等基础支撑，公司实现产品结构进一步优化。报告期内，公司进一步加大了 HDI 等高附加值产品的比例。在产品应用结构方面，积极布局高清 LED 显示、智能 4G 手机及通讯、新能源汽车电子、智能可穿戴终端、智能医疗终端、AR/VR、人工智能等新兴发展领域。

二、经营管理优化

1、成本管控：公司继续深化全面预算管理，细致梳理各项费用，加强成本管理，细化车间物耗、人工工时、水电消耗等绩效考核标准，利用信息化管理手段对生产成本进行长期跟踪、优化和监督。报告期，公司重点加强了对原材料采购成本的管控，通过对采购部管理架构调整、采购制度的修订、供应商管理改善及采购绩效评价体系的完善，严格控制原材料成本，对推动公司盈利增长发挥重要作用。

2、品质管控：坚持贯彻“品质至上、客户满意”的经营宗旨，完善品质管理流程，落实品质责任制，对典型品质问题成立专案小组，攻克品质难关。定期开展“品质月”活动，提升全员品质意识，强化执行力。报告期内，公司新产品良率持续提升。

3、安全生产：公司一向重视安全生产，报告期内，公司进一步完善了安全生产管理责任制，层层落实安全生产责任，管理干部带头值班，对全厂范围内进行安全隐患排查，相关部门根据整改意见及时整改落实。加大了安全教育培训力度，包括规范作业、应急处理、消防演习等，提高了全员安全意识及实际操作水平，确保公司生产经营安全有序进行。

4、考核激励：报告期内，公司进一步深化内部考核、激励机制。继续实施以净利润（结合EVA指标）导向作为主要考核目标的绩效考核与分配体系，确保责任明确，激励清晰，奖罚分明，有效推进团队管理优化。公司于2017年3月完成限制性股票激励计划首次授予，股权激励的实施，使员工与公司共享企业发展成果，有力激发团队的积极性和创造性，同时提高公司对优秀人才的吸引力。

三、技术研究开发

报告期内，为促进公司高端高密度线路板的发展，公司研发投入约1700万元。报告期内开展了“智能可穿戴终端用高密度印制电路板关键技术研究”、“智能车载电子印制电路组件关键技术研究”、“Any-layer HDI印制电路板关键性技术研究”、“LED拼接屏印制电路板制作工艺技术研究”、“高阶HDI板叠孔制造工艺的研究”、“印制电路板激光直接成像曝光技术的研究”、“HDI板新型盲孔填孔技术研究”、“充电桩用印制电路板（铜基板）工艺技术研究”、“高频、高速印制电路板阻抗控制及信号完整性研究”等多个项目的研发工作。

报告期内，公司获得授权专利3项，发表技术论文2篇，荣获中国电子电路行业第四届“优秀民族品牌企业”称号，上述成果的取得，进一步增强了公司的核心竞争力、巩固了行业内技术领先优势，为实施公司中长期计划和达成中期经营计划目标提供了足够的工艺与技术保障。

四、战略创新发展

公司继续坚定不移地实施向医疗健康产业进行创新发展的战略。报告期内，公司与深圳市蓝韵医学影

像有限公司签署了《增资暨股权转让协议》，投资8000万元获得其20%股权。本次投资有利于加快公司向医疗领域的产业布局，公司将充分利用蓝韵影像在医疗健康领域的行业优势与运营管理经验，结合上市公司优势进一步实现资源优化整合。公司已设立全资医疗子公司开展相关业务，引进并储备相关人才，做了大量项目考察与产业分析工作，后期将择机通过并购重组、投资等多种方式进一步推动创新业务发展战略。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据财政部于2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）要求，自规定的实施日2017年6月12日开始执行该项会计准则，并且对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。根据以上规定，将修改财务报表列报，在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

公司已按要求修改财务报表列报，本次会计政策变更不影响公司本报告期报表项目及金额，不涉及以前年度的追溯调整。公司后续将按照修订后的会计政策执行。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

惠州中京电子科技股份有限公司

2017年8月24日